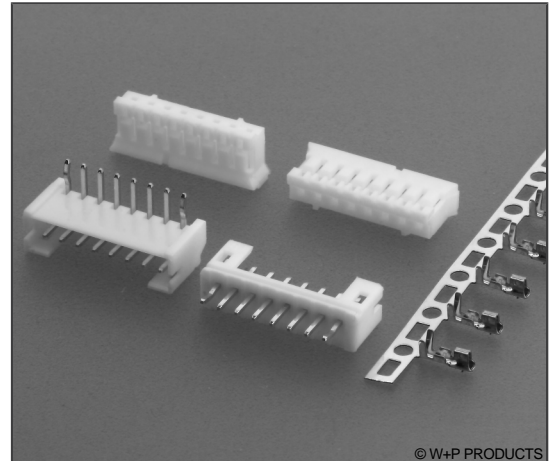


Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

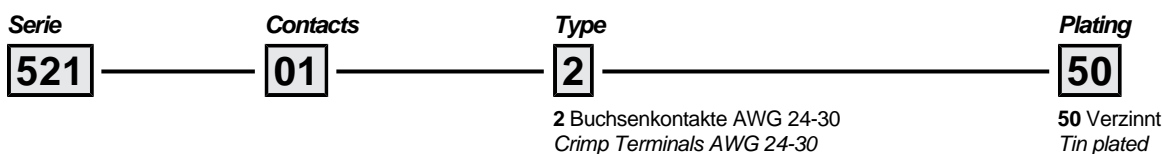
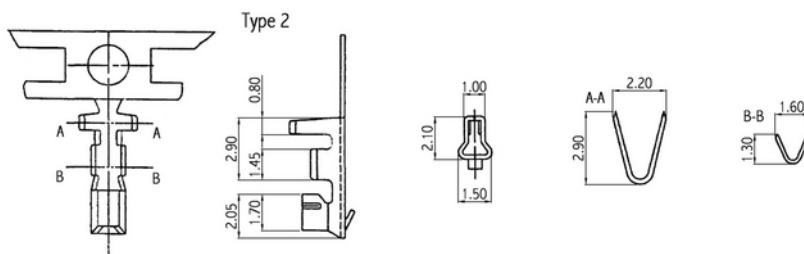
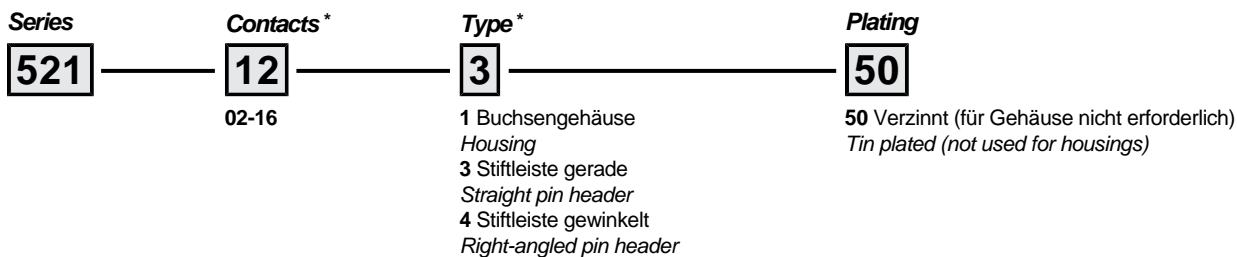
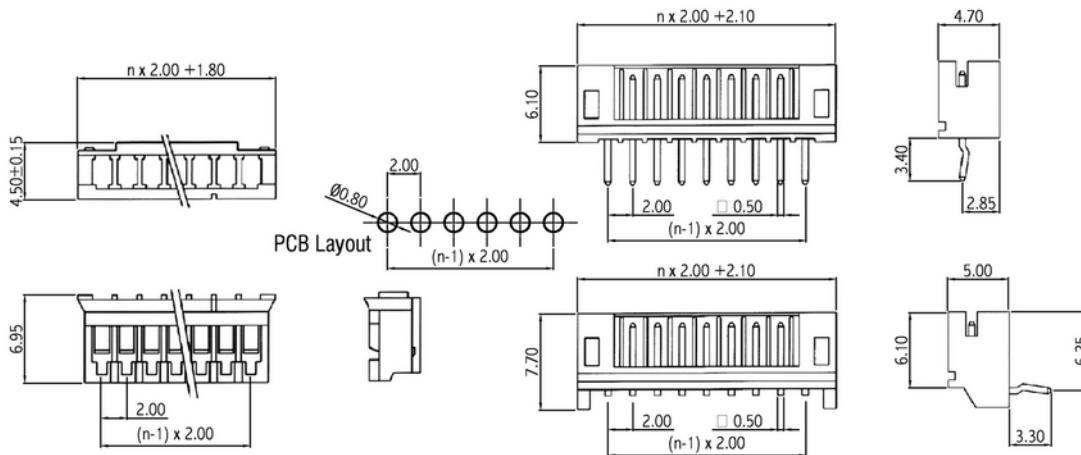
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.50mm, copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 30 ~ 24
Applicable wire Gauge	AWG 30 ~ 24
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	800V _{AC}
Test Voltage	800V _{AC}
Nennspannung	100V _{AC}
Voltage Rating	100V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS

Buchsengehäuse passt auch zur Serie:
Housing mates also with Series:

5210



* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

